

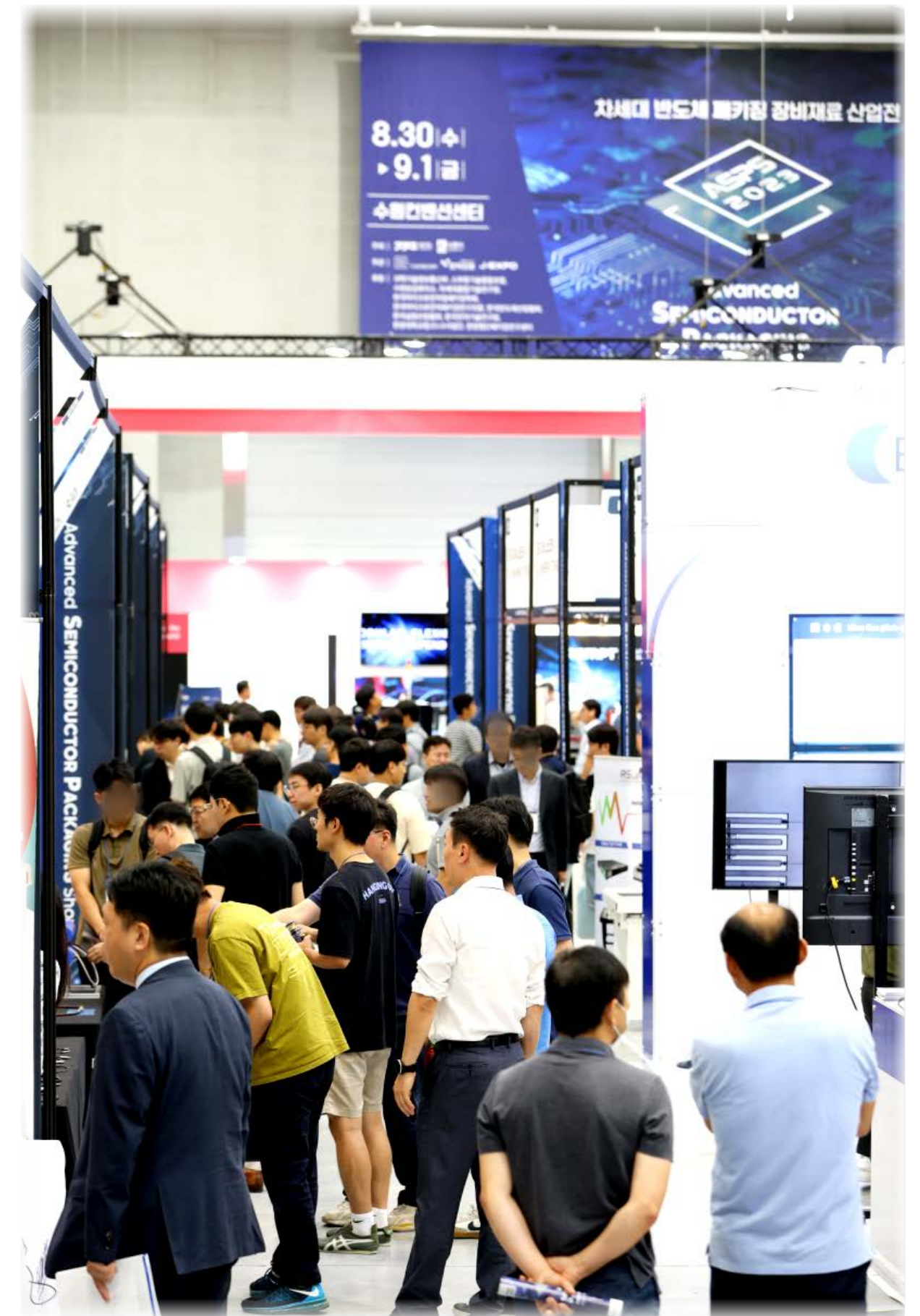


Advanced
**SEMICONDUCTOR
PACKAGING**
Show

2023 차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전

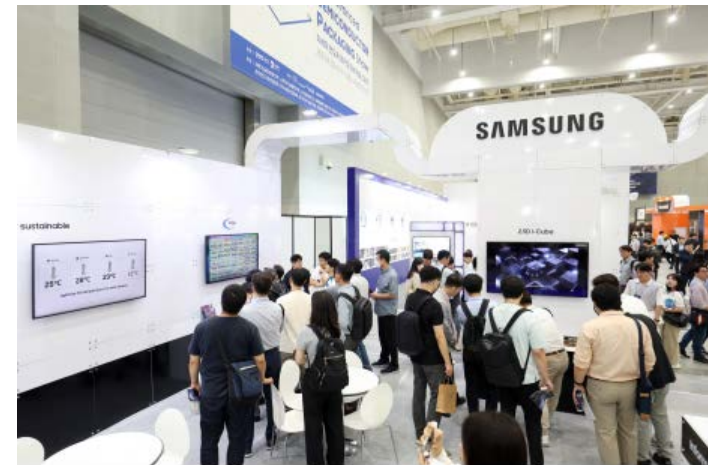
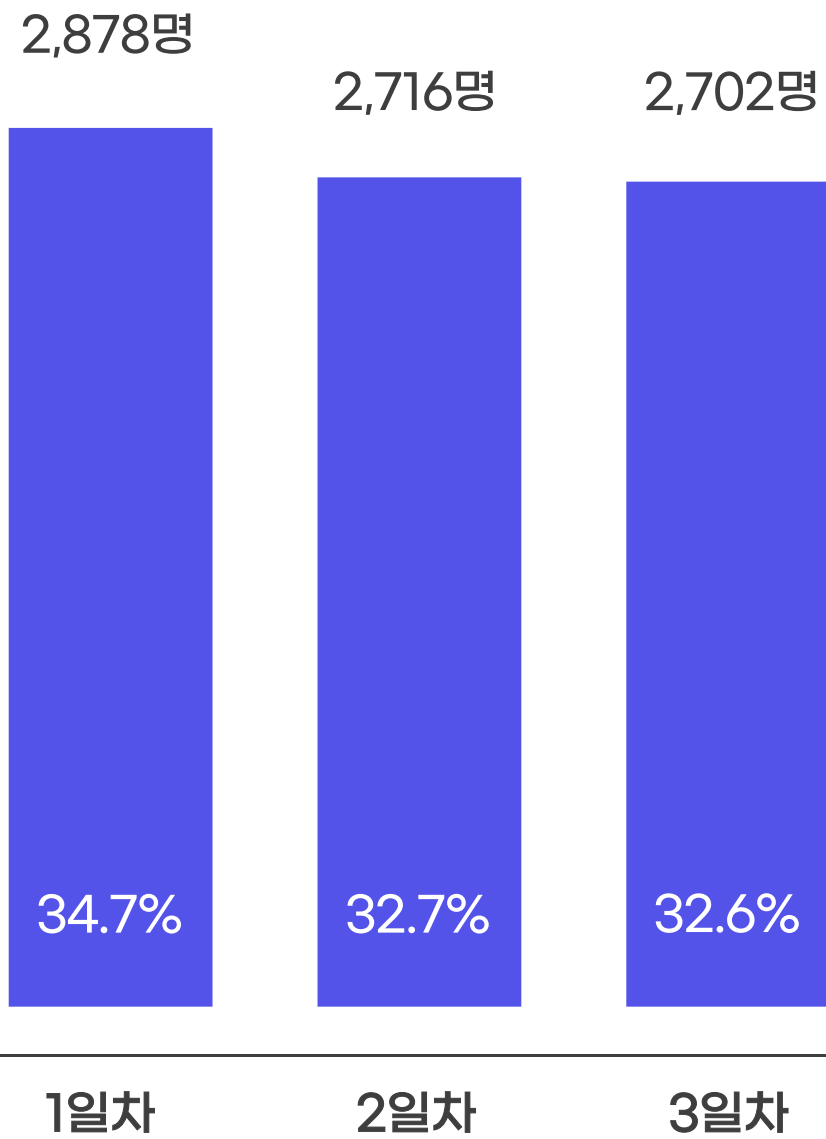
결과보고서

- 명 칭** (국) 2023 차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전
(영) Advanced Semiconductor Packaging Show 2023
(약) ASPS 2023
- 기 간** 2023.8.30(수)-9.1(금), 3일간
- 장 소** 수원컨벤션센터
- 규 모** 참가업체 91개사 276부스
- 관 람 객** 전시회 8,296명 / 부대행사 2,000여명 이상
- 주 최** 경기도, 수원시
- 주 관** (재)수원컨벤션센터, (주)전자신문사, (주)제이엑스포
- 후 원** 과학기술정보통신부, 소부장기술융합포럼, 수원상공회의소, 차세대융합기술연구원, 한국마이크로전자및패키징학회, 한국마이크로전자패키징연구조합, 한국반도체산업협회, 한국실장산업협회, 한국전자기술연구원, 한양대학교링크3.0사업단, 한양첨단패키징연구센터



관람객 합계 : **8,296명**

참가업체 합계 : **91개사**
276부스



KEY VISITORS

- ALT
- AMKOR TECHNOLOGY
- APACT
- ASE KOREA
- ASML
- AT SEMICON
- DB HITEK
- DOOSAN TESNA
- GMTEST
- HANA MICRON
- HANWHA NXMD
- HYUNDAI MOBIS
- HYUNDAI MOTOR
- INTEL
- ITEK
- JCET STATS CHIPPAK KOREA
- LB LUSEM
- LB SEMICON
- LG ELECTRONICS
- LG INNOTEK
- MCNEX
- MEMSPACK
- NEPES
- NEPES ARK
- NEPES LAWEH
- PARTRON
- QUALCOMM
- SAMSUNG
- SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS
- SAMSUNG SDI
- SAPIEN SEMICONDUCTORS
- SFA SEMICON
- SIEMENS
- SIGNETICS
- SK HYNIX
- SKAICHIPS
- STECO
- TEKLINE KOREA
- TEXAS INSTRUMENTS
- WINPAC

총 2,000여명 이상 참가

2023 차세대 반도체 패키징 장비재료 혁신전략 컨퍼런스

"혁신적인 반도체 패키징 기술과 미래"

2023 KAMP/소부장포럼 국제 심포지움

"미래의 선택 : 반도체 패키징 / 2차전지의 미래 그리고 비즈니스 찬스"

ASPS 2023 참가업체 기술 세미나

델타아이티, 자이스코리아, 태성에스엔이, 엔트리움

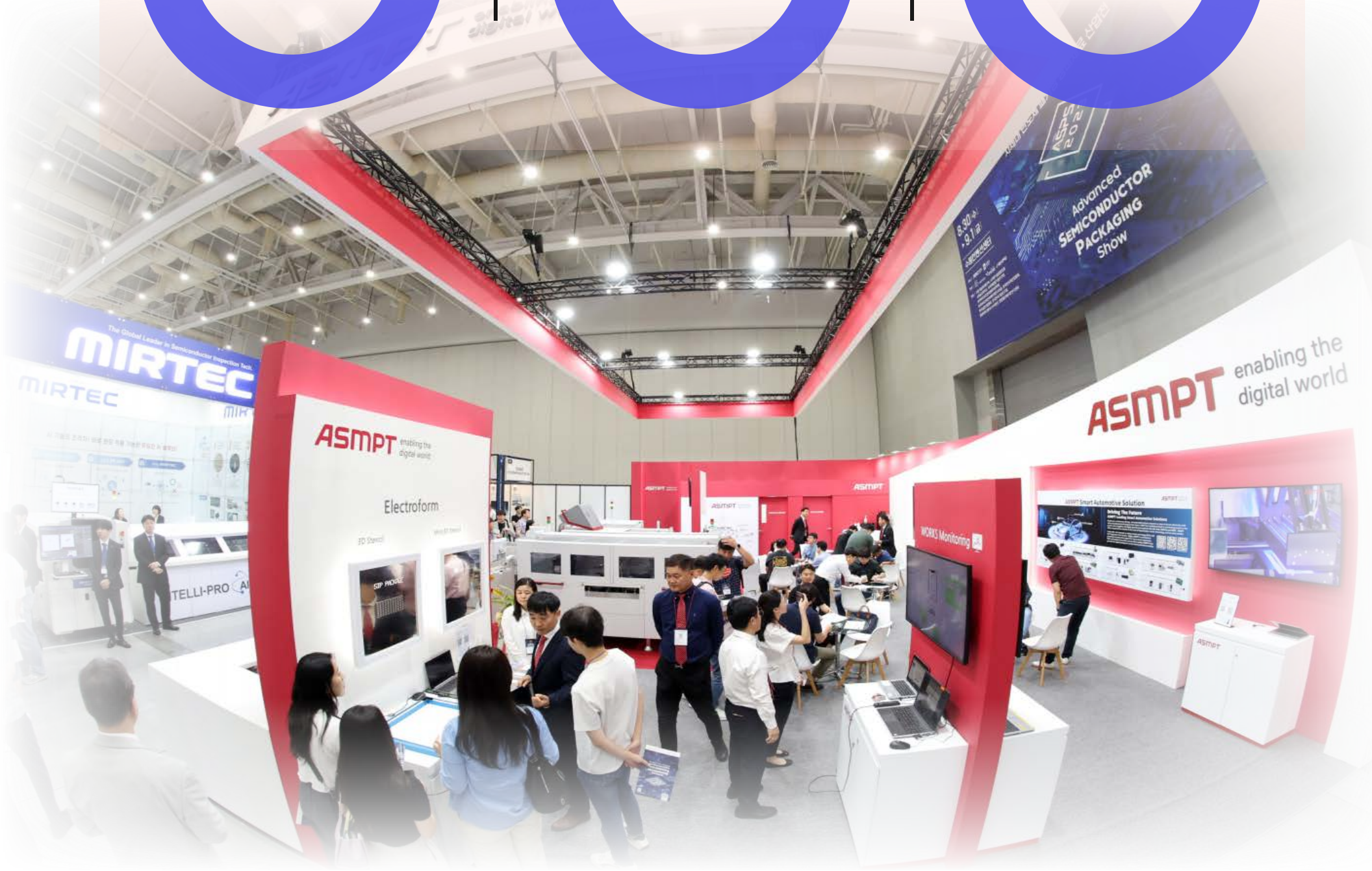
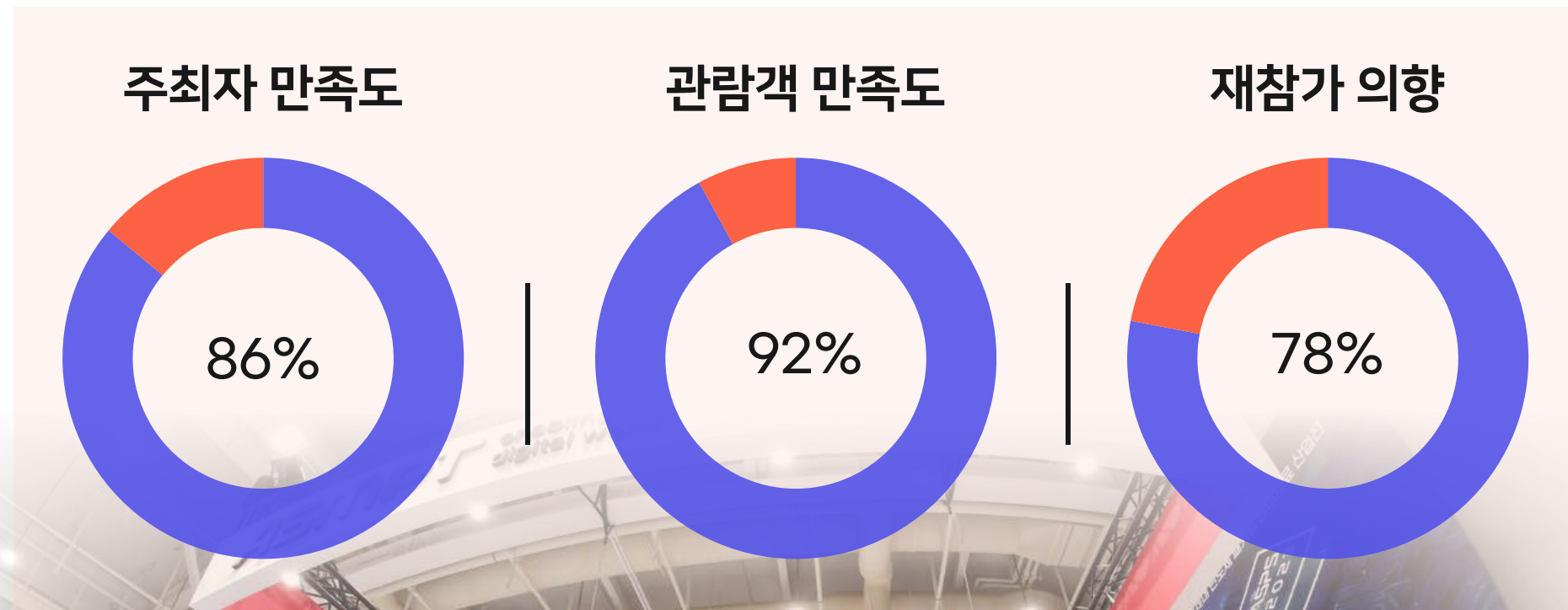
수원상공회의소 세미나 & 설명회

- 1) 지식재산으로 알아본 반도체 기술 동향
- 2) 기술거래 설명회

한국나노기술연구원 세미나

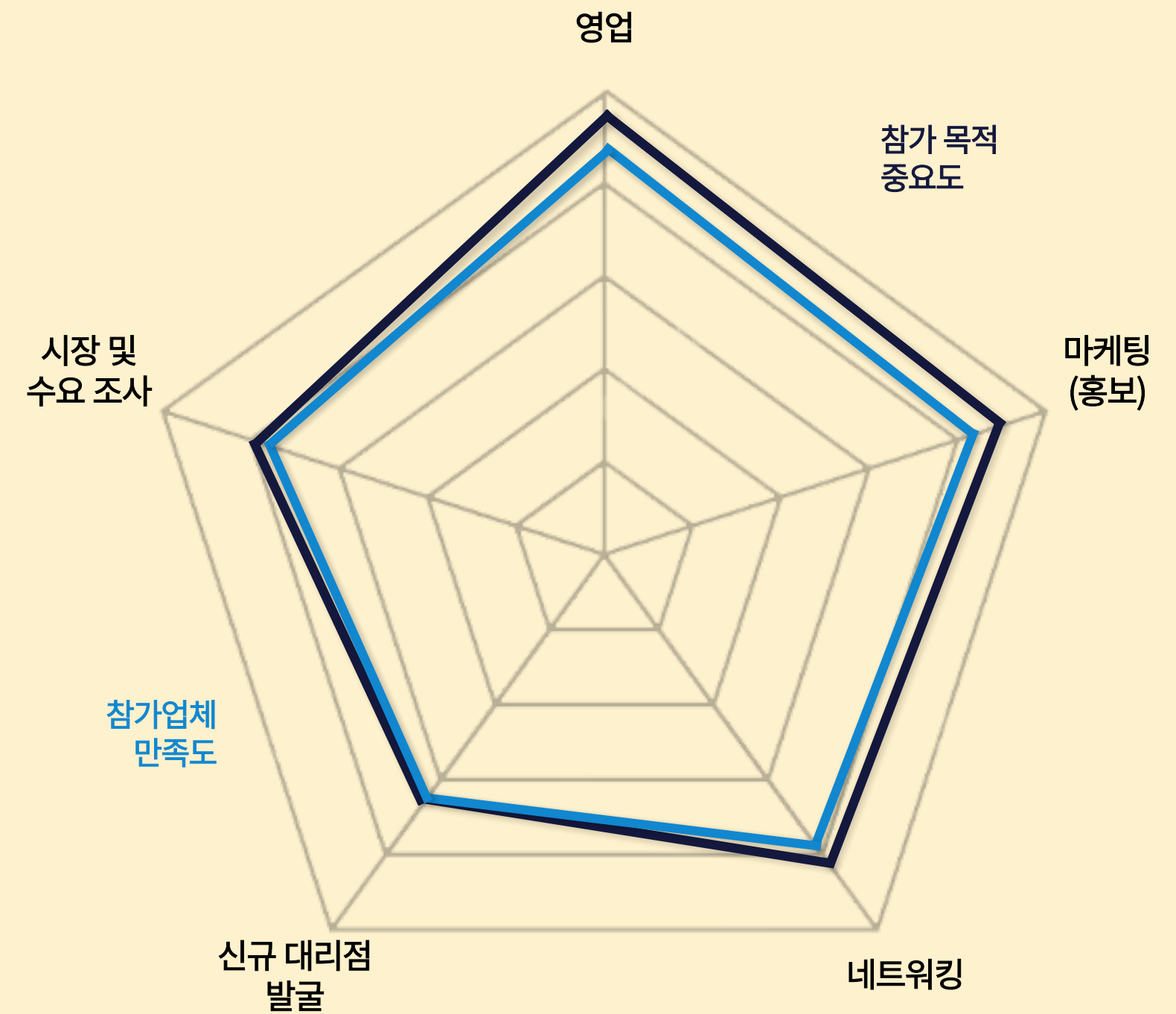
- 1) 시스템 반도체 OSAT분야 전문 교육 세미나
- 2) TSV 기술의 과거 현재 그리고 미래



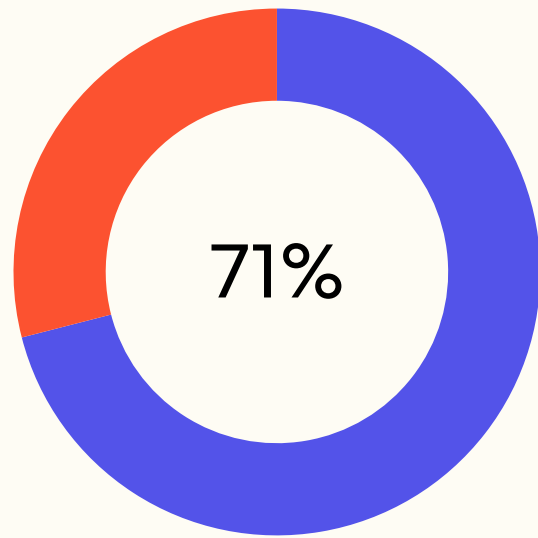


전시회 참가 목적의 중요도 및 만족도

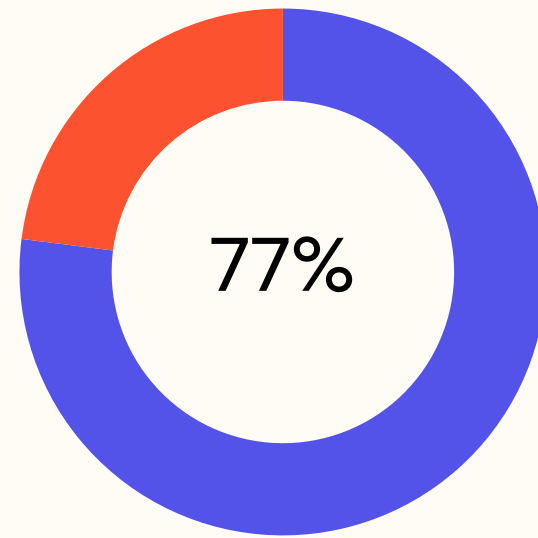
참가업체 설문 통합 결과



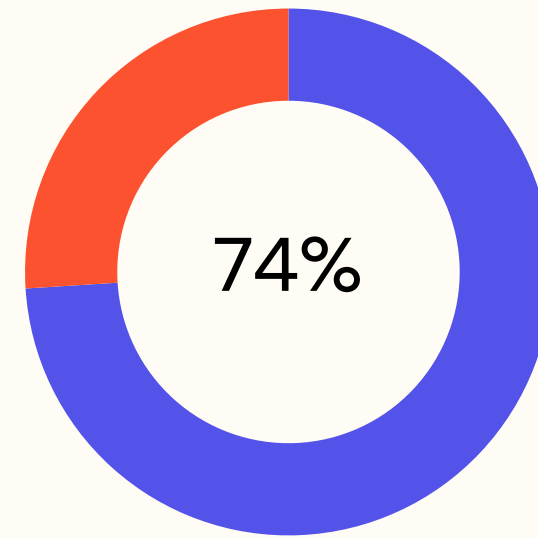
전시회 만족도



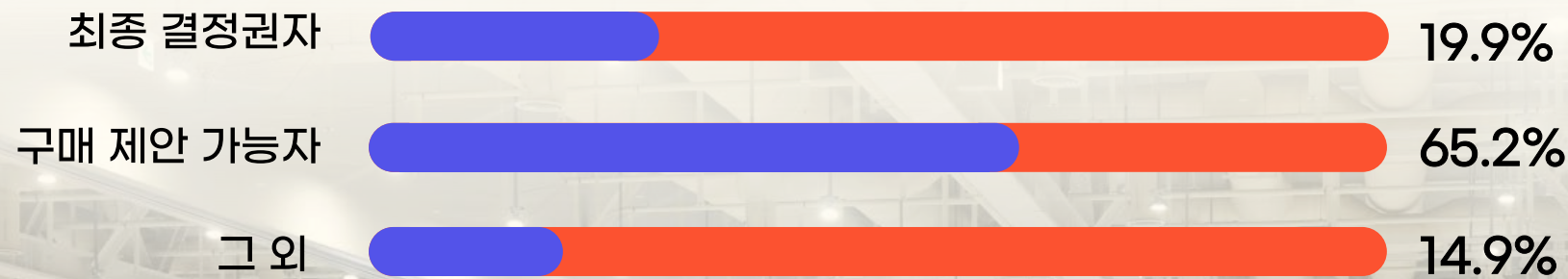
참가업체 만족도



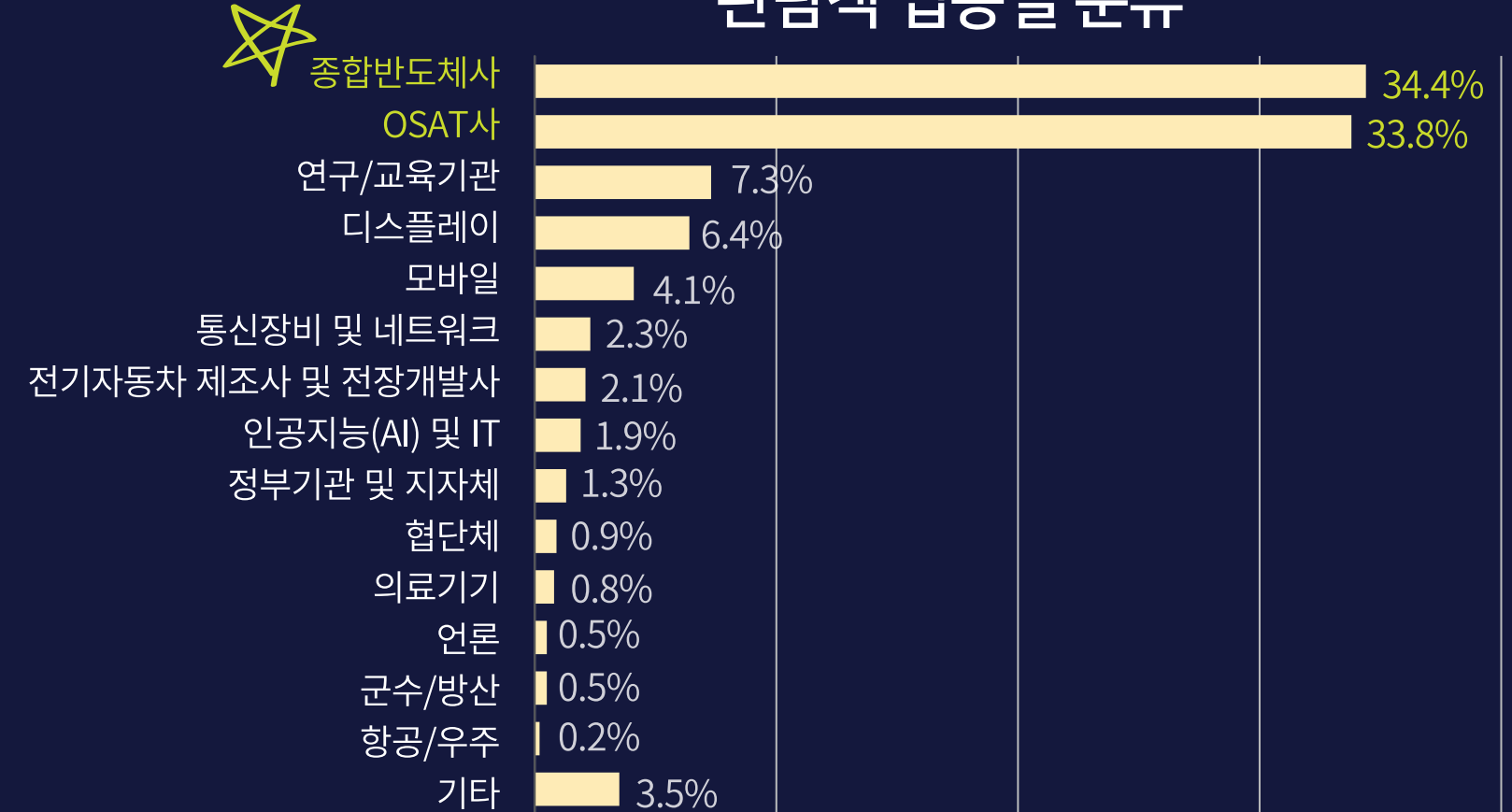
재방문 의향



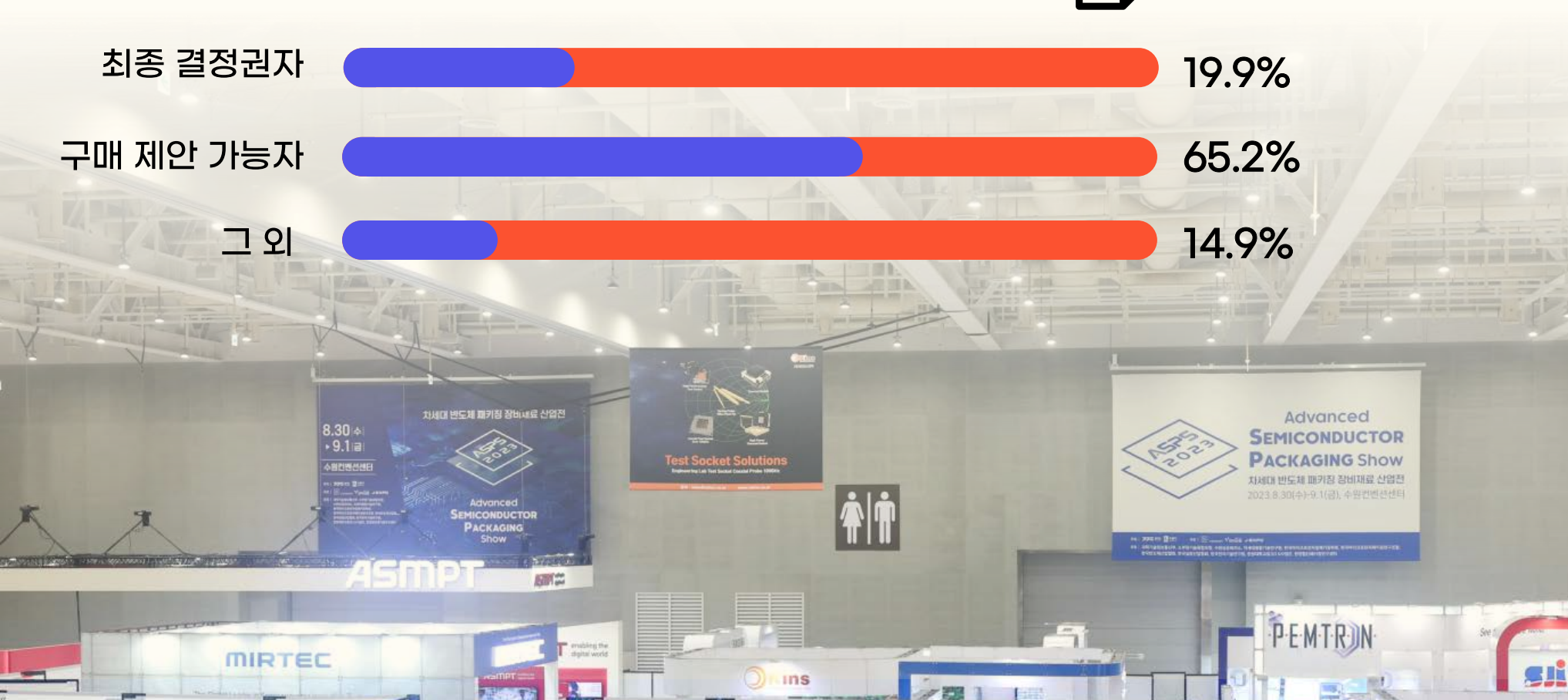
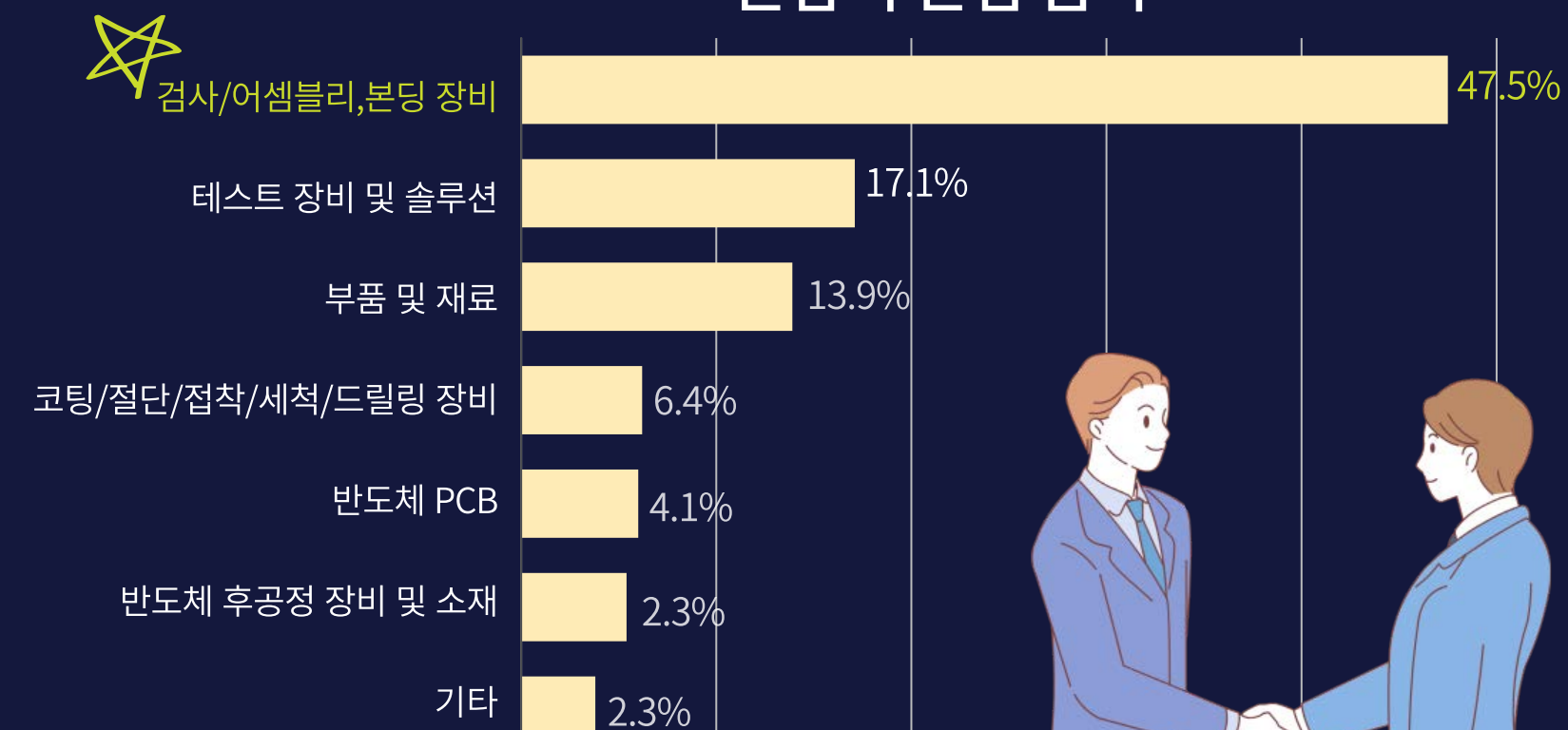
방문 관람객 구매 권한



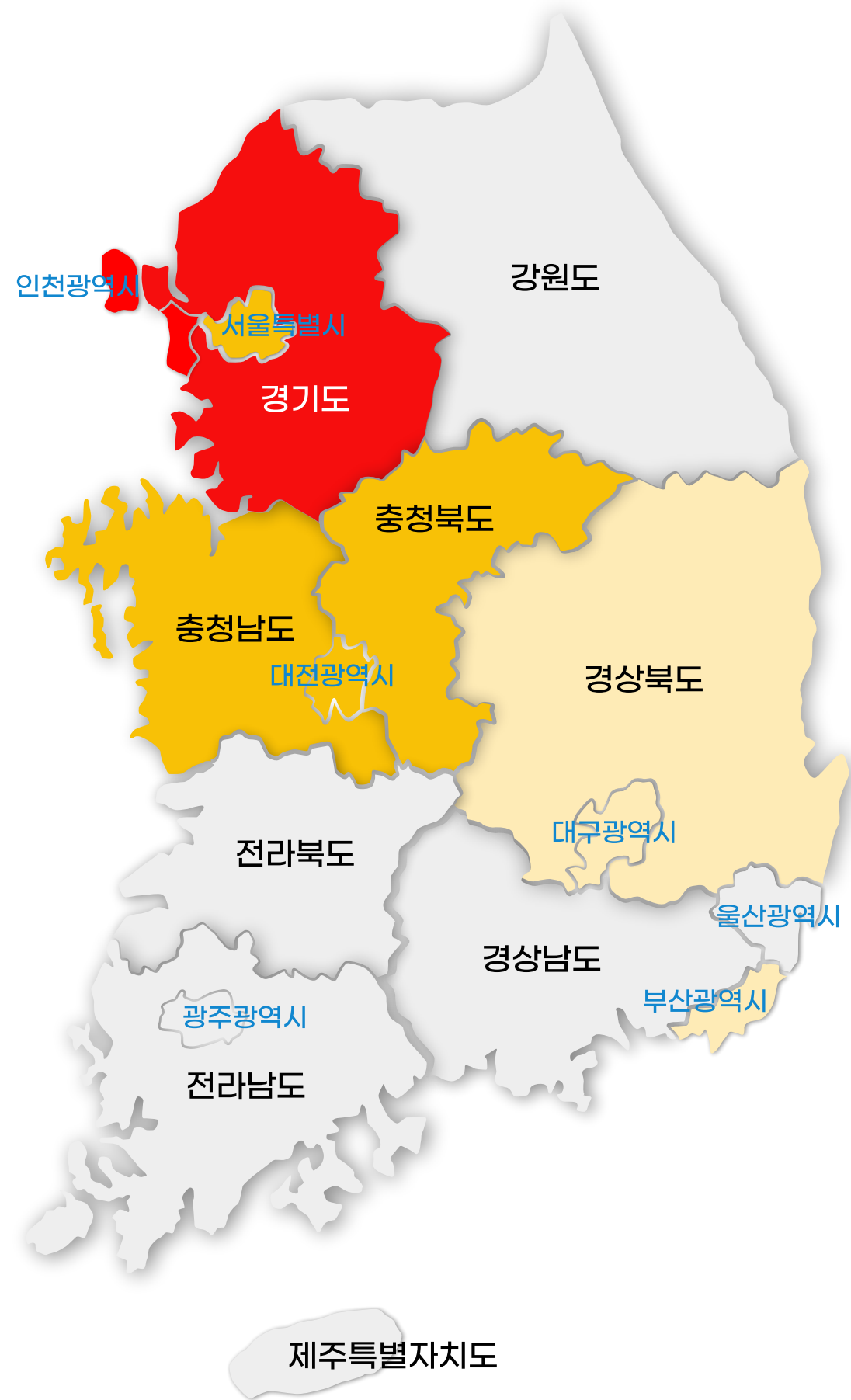
관람객 업종별 분류



관람객 관심 품목



06 관람객 지역별 분석



경기/인천	59.9%
대전/충청	11.6%
서울	10.4%
대구/경북	1.0%
부산/경남	0.5%
광주/전남북	0.2%
강원	0.1%
해외	0.4%
기타	15.9%

무료 관람객 이동편의를 위한

셔틀버스 운행

탑승지 - 광고중앙역 4번출구

광고중앙역 > 수원컨벤션센터
 8월 30일(수)-9월 1일(금) : 15분간격 상시운행
 (점심시간 12:00-12:30, 30분간 미운행)

탑승지 - 수원컨벤션센터 입구

수원컨벤션센터 > 광고중앙역
 8월 30일(수)-9월 1일(금) : 15분간격 상시운행
 (점심시간 12:00-12:30, 30분간 미운행)





관람객 피드백



관람객 A

“ 소규모 전시회였지만 구성이 알차습니다 ”



관람객 B

“ 시장 동향을 파악할 수 있는 좋은 기회였습니다 ”



관람객 C

“ 다른 전시회와 다르게 장비를 가지고 참가한 업체가 많아 상세하게 보고 느낄수 있었습니다 ”

전시회 종료 후 관람객 설문조사를 통해 받은 피드백입니다.



참가업체 피드백



참가업체 A

“ 1회임에도 불구하고 많은 관람객이 방문하여 만족함 ”



참가업체 B

“ 실제 장비업체 관계자들의 방문이 많아서 좋았습니다. ”



참가업체 C

“ 전시회 배치와 동선이 매끄러웠던 것이 좋았음 ”

전시회 종료 후 참가업체 설문조사를 통해 받은 피드백입니다.



Advanced 차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전 SEMICONDUCTOR PACKAGING Show

참가업체 수



91개사
(국내 81 / 해외 10)

부스 수



276부스
(국내 241 / 해외 35)

관람객 수



8,296명
(국내 8,265 / 해외 31)

Coming up next show



Advanced 차세대 반도체 패키징 소부장 산업전
Semiconductor Packaging & Chiplet Show
2024.8.28(수)-8.30(금), 수원컨벤션센터